



**ADVANTEST**<sup>®</sup>

# 2022年度（2023年3月期） 決算説明会

2023年4月26日  
株式会社アドバンテスト

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

# ご注意

---

## 会計基準について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている実績や見通し数値は、国際会計基準（IFRS）に基づいて作成しています。

## 将来の事象に係る記述に関する注意

- 本プレゼンテーション資料およびアドバンテスト代表者が口頭にて提供する情報には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

## 本資料の利用について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている情報は、各国の著作権法、特許法、商標法、意匠法等の知的財産権法その他の法律及び各種条約で保護されています。事前に当社の文書による承諾を得ない限り、法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用（改変、複製、転用等）することを禁止します。



```
...mirror_ob.select = 0
operation == "MIRROR_X":
mirror_mod.use_x = True
mirror_mod.use_y = False
mirror_mod.use_z = False
operation == "MIRROR_Y":
mirror_mod.use_x = False
mirror_mod.use_y = True
mirror_mod.use_z = False
operation == "MIRROR_Z":
mirror_mod.use_x = False
mirror_mod.use_y = False
mirror_mod.use_z = True

selection at the end -add @
obj.select-1
mirror_ob.select-1
context.scene.objects.active
("Selected" + str(modifier))
mirror_ob.select = 0
```

## 2022年度決算報告

取締役 兼 経営執行役員  
CFO & CCO (Chief Financial Officer & Chief Compliance Officer)  
管理本部長 藤田 敦司

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

**ADVANTEST**<sup>®</sup>

## FY22業績ハイライト

- FY22は波瀾の1年。コロナ特需の終えんと世界経済の低迷、半導体市場の落ち込みと、事業環境は年度前半と後半で大きなギャップが生じた
- そのような環境下、通期で過去最高の売上高、営業利益、当期利益を達成
  - 幅広い製品ポートフォリオとグローバル販売・サポート網の強化でシェア拡大
  - 戦略的な部材調達や生産・出荷管理など柔軟なオペレーション
  - 大幅な円安も業績を押し上げ
- ROEは過去最高の39.3%（前年度：30.4%）

### ○ 2022年度業績ハイライト

- 2022年度は、コロナ特需の終えんと世界経済の低迷、半導体市場の落ち込みと、事業環境は年度前半と後半で大きなギャップが生じた、波瀾の1年でした。
- その中であっても、売上高、営業利益、当期利益ともに、それぞれ過去最高となる実績を収めることができました。
- 幅広い製品ポートフォリオとグローバル販売・サポート網の強化により、マーケットシェアを拡大したこと、加えて、需要変動の最中においても、顧客の納期要求に最大限応えるべく、戦略的な部材調達や生産および出荷管理など、柔軟なオペレーションの実践に取り組んだことが好業績の原動力となりました。
- 前年度比で大幅な円安の進行も業績を押し上げました。
- ROEについては過去最高の39.3%でした。
- 不確実な事業環境が続く中、当社ビジネスを継続して支えていただいているお取引先各社をはじめ、従業員、すべてのステークホルダーの皆様へ感謝申し上げます。

## FY22業績概要

(億円)

	FY21	FY22			
	実績	1月時点 予想	実績	前年度比	
				増減額	増減率
売上高	4,169	5,500	5,602	+1,433	+34.4%
営業利益	1,147	1,700	1,677	+530	+46.2%
営業利益率	27.5%	30.9%	29.9%	+2.4pts	
税引前利益	1,163	1,740	1,713	+549	+47.2%
当期利益	873	1,300	1,304	+431	+49.4%
当期利益率	20.9%	23.6%	23.3%	+2.4pts	
為替レート	1米ドル	112円	134円	134円	22円 円安
	1ユーロ	130円	139円	140円	10円 円安
1株当たり配当額 (年間)	120円	135円	135円*1	+15円	
自己株式取得額	700	-	500	-200	
総還元性向*2	107%	-	58%	-49pts	

\* 1: FY22の期末配当は2023年5月19日開催の取締役会において正式決定する予定です

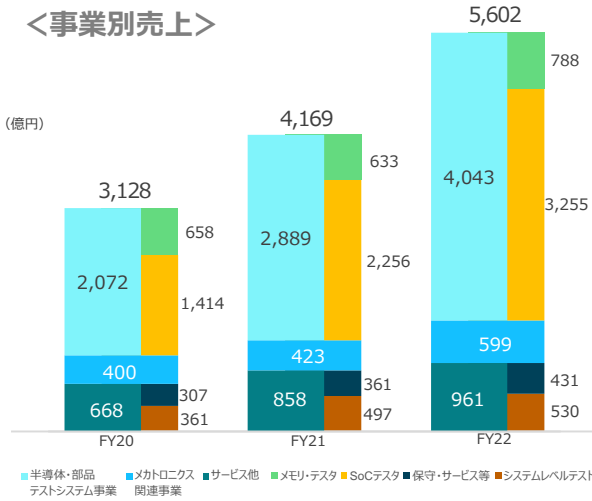
\* 2: 総還元性向 = (配当総額 + 自己株式取得額) ÷ 当期利益

### ○ 2022年度業績概要

- 2022年度の業績はスライドの通りとなります。
  - 売上高 5,602億円
  - 営業利益 1,677億円
  - 当期利益 1,304億円
- 先ほど申し上げた通り売上高および営業利益、当期利益は過去最高の実績となり、前年度から大きく増加しました。
- 1月時点の通期予想との比較では、売上高は、顧客への製品納入が想定以上に進捗し、通期予想を100億円ほど上回る結果となりました。
- しかしながら第4四半期にシステムレベルテスト(SLT) 事業などの一部製品で棚卸資産の評価損を計上したことや、製品ミックスが悪化したことから、営業利益、営業利益率はともに通期予想を少し下回る結果となりました。
- 当期利益は、概ね通期予想通りの着地となりました。
- 期末配当予想は70円、中間配当実績 65円と合わせ、年間配当予想は 135円とします。自己株式取得と配当を合わせた総還元性向は 58%となります。

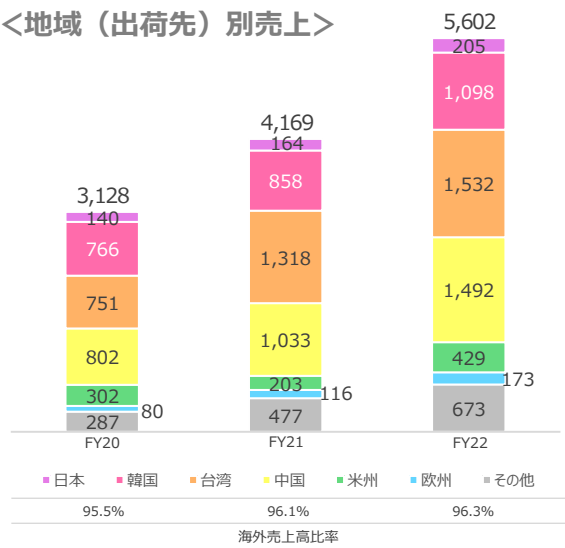
# FY22売上実績 年度比較

## <事業別売上>



\*合計にはセグメント間の内部取引の消去分が含まれます

## <地域（出荷先）別売上>



## ○ 2022年度の売上高実績

- こちらは年度売上実績です。
- 半導体市場の減速感が強まり、半導体の生産数量が減少する中でも、当社のビジネスとしては、半導体の高性能化を背景としたテスト需要の増加が、生産数量の落ち込みによる需要の減少を補いました。
- SoCテストでは、高水準なスマートフォン関連のアプリケーション・プロセッサ（APU）向けに加えハイ・パフォーマンス・コンピューティング（HPC）やAI関連の半導体向けテストが売上を牽引しました。
- 加えて需要が強い自動車・産業機器向けなどにおいても売上が伸長しました。
- メモリ・テストは、メモリ半導体価格が下落しているにもかかわらず、高性能メモリ半導体向けを中心とした顧客の投資が年度を通して継続され、売上は前年度を上回りました。
- 地域別では、全地域で売上が拡大しました。台湾が前年度に引き続き最大仕向け地となっています。

## 四半期業績推移

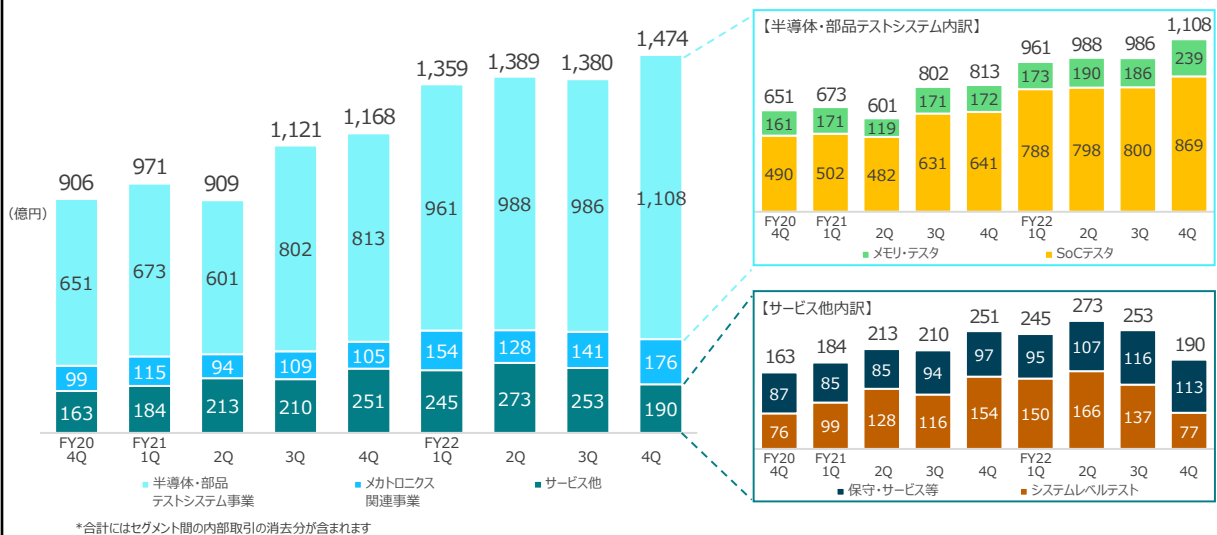
(億円)

	FY21				FY22				前期比		前年同期比	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	971	909	1,121	1,168	1,359	1,389	1,380	1,474	+94	+6.8%	+306	+26.2%
売上総利益	547	501	648	663	789	799	816	787	-29	-3.6%	+124	+18.7%
売上総利益率	56.4%	55.0%	57.9%	56.7%	58.1%	57.5%	59.1%	53.4%	-5.7pts		-3.3pts	
営業利益	261	214	335	337	448	431	412	386	-27	-6.5%	+49	+14.4%
営業利益率	26.9%	23.5%	29.9%	28.8%	32.9%	31.1%	29.9%	26.2%	-3.7pts		-2.6pts	
税引前四半期利益	257	216	340	350	484	468	377	384	+8	+2.1%	+34	+9.7%
四半期利益	193	159	257	264	365	347	286	306	+19	+6.8%	+42	+15.9%
四半期利益率	19.9%	17.5%	22.9%	22.6%	26.8%	25.0%	20.8%	20.8%	+0.0pts		-1.8pts	
為替レート	1米ドル	109円	110円	112円	115円	124円	135円	144円	133円	11円 円高	18円 円安	
	1ユーロ	131円	131円	130円	130円	134円	139円	144円	142円	2円 円高	12円 円安	

### ○ 2022年度第4四半期の業績概要

- 2022年度の4Qは、過去最高の売上高を達成しました。
- 売上総利益率に関しては、SLT事業などの一部製品で棚卸資産の評価損を計上したことや、製品ミックスが悪化したことから、前期比で下回る結果となりました。
- 各項目の詳細は次ページ以降でご説明いたします。

## 四半期売上高 事業セグメント別



○ 2022年度第4四半期の売上高

○ 半導体・部品テストシステム事業

- 前期（2022年度第3四半期）比12.4%増 1,108億円
- SoCテストは、前期比69億円増の869億円でした。ハイエンドSoC向けの売上が伸び悩む一方で、アナログ半導体向けなどでの売上が伸長しました。
- メモリ・テストは、前期比53億円増の239億円でした。DRAMおよび不揮発性メモリ向けの製品納入が共に伸長しました。

○ メカトロニクス関連事業

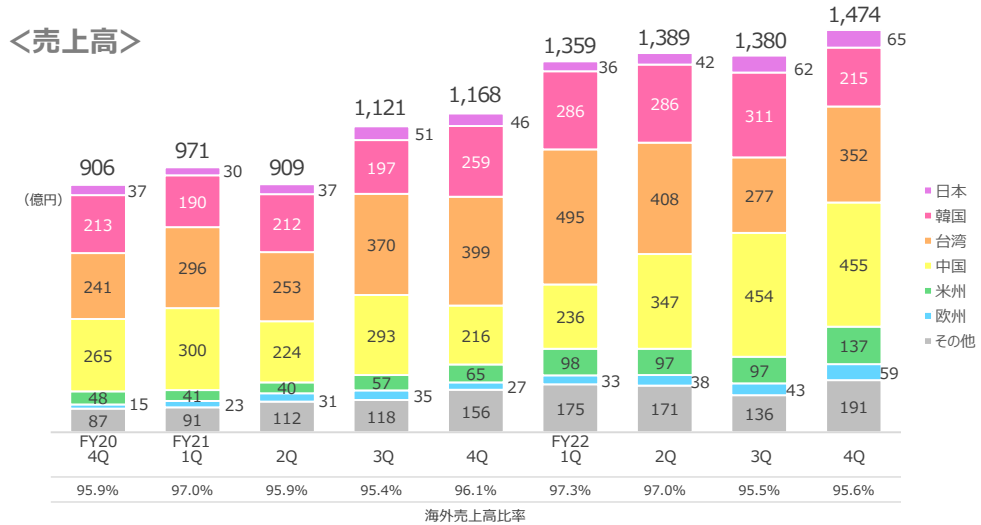
- 前期比23.9%増 176億円
- 半導体メーカーにおけるEUV露光技術の採用拡大を背景に、ナノテクノロジー製品の売上が増加しました。

○ サービス他

- 前期比24.6%減 190億円
- 民生機器関連での市況低迷の影響を受け、特定顧客向けの比率が高いSLT事業の売上が大きく減少しました。



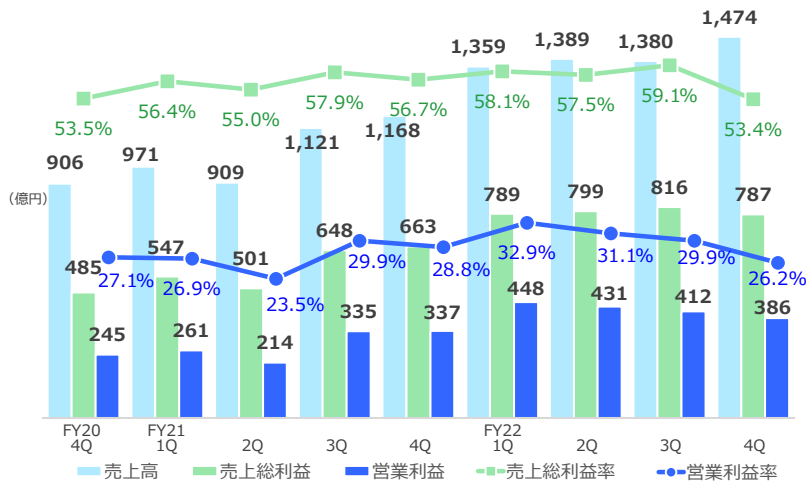
## 四半期売上高 地域(出荷先)別



### ○ 2022年度第4四半期の地域別売上高

- 台湾  
SoCテスト、メモリ・テストともに売上が増加しました。
- その他地域  
東南アジアを中心に車載や産業機器関連の製品納入が進みました。
- 韓国  
市況低迷を受けてスマートフォン関連での製品販売が減少しました。

## 売上高/売上総利益/営業利益



	(億円)	
	FY21	FY22
売上高	4,169	5,602
売上総利益	2,359	3,191
売上総利益率	56.6%	57.0%
販管費等	1,212	1,514
営業利益	1,147	1,677
営業利益率	27.5%	29.9%

### ○ 2022年度第4四半期の売上高/売上総利益/営業利益

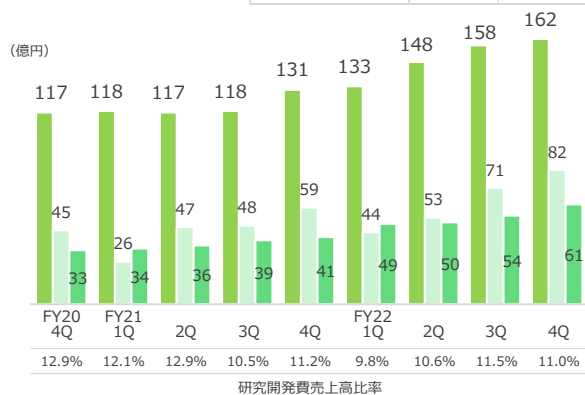
- 売上総利益率 53.4%
- 売上総利益率が前期比で大きく低下しましたが、その理由はまずメモリ/ストレージ向けのSLT事業などで棚卸評価損を30億円程度計上したためです。
- 加えて、ハイエンドSoC向けの売上構成比率が相対的に低下したため、売上ミックスが悪化し、前期比で売上総利益率が減少しました。
- 販売費および一般管理費等（その他収益・費用を合算） 401億
- 営業利益 386億円
- 営業利益率 26.2%

## 投資等/キャッシュ・フロー

### <投資等>

- 研究開発費
- 設備投資
- 減価償却費

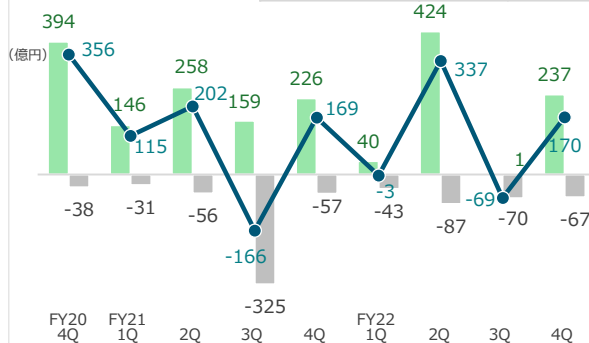
	FY21	FY22
研究開発費	484	601
売上高比率	11.6%	10.7%
設備投資	180	250
減価償却費	150	214



### <キャッシュ・フロー>

- 営業キャッシュ・フロー
- 投資キャッシュ・フロー
- フリー・キャッシュ・フロー

	FY21	FY22
営業キャッシュ・フロー	789	702
投資キャッシュ・フロー	-469	-267
フリー・キャッシュ・フロー*	320	435



\*フリー・キャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー

### ○ 研究開発費等

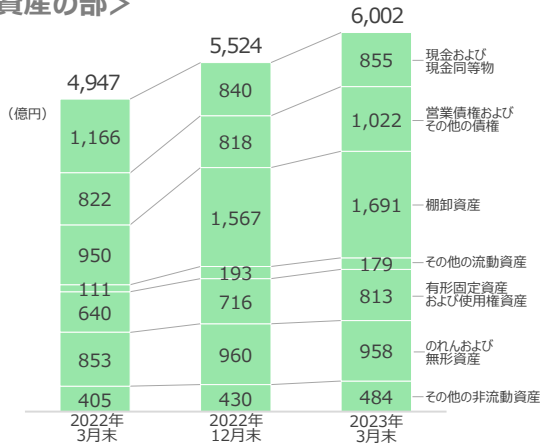
- ・ 第4四半期は、研究開発費162億円、設備投資82億円、減価償却費61億円でした。
- ・ 2022年度の研究開発費601億円、設備投資250億円、減価償却費214億円となりました。中長期的なさらなる成長に向けた投資や開発を推し進めた1年でした。

### ○ キャッシュ・フローの状況

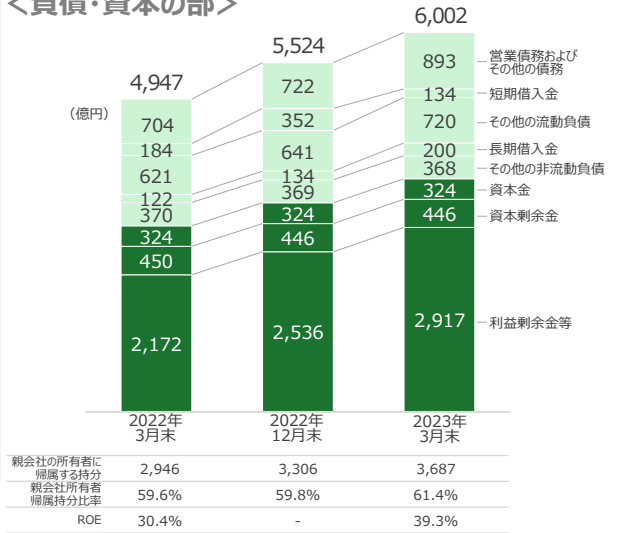
- ・ フリー・キャッシュ・フローについては、第4四半期が170億円、2022年度は435億円でした。

# 連結財政状態

## <資産の部>



## <負債・資本の部>



### ○ 2023年3月末時点のバランス・シート

- ・ 総資産 6,002億円
- ・ 現金および現金同等物 855億円
- ・ 棚卸資産 1,691億円
- ・ のれんおよび無形資産 958億円
- ・ 親会社の所有者に帰属する持分 3,687億円
- ・ 親会社所有者帰属持分比率 61.4%
- ・ 2022年度は部材調達難の中で、中長期的な観点で顧客要求への追従力を高めるため、在庫を厚めに保有してまいりましたが、市況の変化に応じて棚卸資産管理の強化に努めてまいります。



# 第2期中期経営計画（MTP2）の進捗と 2023年度事業見通し

代表取締役 兼 執行役員社長 Group CEO 吉田 芳明

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

**ADVANTEST**<sup>®</sup>

## 第2期中期経営計画（FY21-FY23）の進捗

	第1期中期経営計画 実績 FY18-20平均	第2期中期経営計画 目標 FY21-23平均	FY21 実績	FY22 実績	FY21-22 平均実績
売上高	2,904億円	4,800~5,200億円	4,169億円	5,602億円	4,885億円
営業利益率	22.3%	27~30%	27.5%	29.9%	28.7%
当期利益	601億円	980~1,200億円	873億円	1,304億円	1,089億円
ROE	29.1%	30~35%	30.4%	39.3%	34.9%
1株当たり当期利益 (EPS)	309円	510~630円	450円	697円	573円

### <成長投資>

	FY21-23 投資枠	FY21 実績	FY22 実績	FY21-22 累計実績
M&A等戦略投資	1,000億円	290億円	35億円	325億円
設備投資	700億円	180億円	250億円	431億円

### <株主還元>

	FY21-23想定	FY21 実績	FY22 実績	FY21-22 累計実績
株主還元額 (配当額+自己株式取得)	2,100億円以上	930億円	750億円	1,681億円

### ○ 第2期中期経営計画の2年目進捗

- 第2期中期経営計画の財務面からみたこれまでの進捗を整理します。
- 2022年7月に、2021年度実績、2022年度見通しを踏まえ、MTP2の各経営指標の修正を行いました。修正目標と比較したMTP2期間の2年間の実績をスライド右側に整理しています。
- 世界経済の景気後退リスクの増大を背景に、事業環境の不確実性が高まる中においても、2年目の進捗としては、過去最高の業績を更新しています。初年度に引き続き、当社が優位性を持つスマートフォン関連、HPC関連、高性能メモリ半導体向けのテスト需要の拡大に加えて、車載・産機・民生向けでも、過去から地道に進めてきた顧客基盤強化策と、製品戦略が功を奏し、関連する売上を広範囲に伸ばすことができました。
- 残念ながら足元は半導体業界全体に逆風が吹いています。アップダウンは避けられないのがこの業界ですので、MTP2の目標数値も3年平均値で設定しています。最終年度の2023年度はダウンイヤーになる見通しですが、目標達成に向け気を引き締めたいと思います。

# MTP2（FY21-FY23）の進捗状況

中長期的な視座のもと、経営基盤強化と事業強化に向け5つの戦略をFY22も着実に実行

戦略	これまでの進捗
<b>1 コアビジネスの強化、重点投資</b>	<b>1</b> FY21より「V93000 EXA Scale」をはじめとする各テスト・ソリューションの拡充を継続。さらにFY22は、メモリ・テスト・セルの新機軸となる「inteXcell」投入や、パワー半導体用試験装置大手のイタリア・CREA社買収を通じ、成長基盤をさらに強化 継続的なセールス・サポート人員増強により、顧客ニーズへの対応力を向上
<b>2 オペレーショナル・エクセレンスの追求</b>	<b>2</b> TechInsights社顧客満足度調査において、3年連続SPE業界首位を達成 グローバル・ビジネス・オペレーション・イニシアティブを発足。業務プロセスの改革を目指す
<b>3 さらなる飛躍への価値探求</b>	<b>3</b> SLT事業において、AI/HPC、スマートフォン、車載関連市場を着々と深耕 テスト・インタフェース事業強化に向け、米・R&D Altanova社をFY21に買収、台湾・Shin Puu社をFY23 1Qに買収完了予定 「Advantest Cloud Solutions™ (ACS)」のサービス基盤を継続的に拡充
<b>4 新事業領域の開拓</b>	<b>4</b> 蛍光検出システムなど、医療機器をはじめとした新事業推進に向け体制整備
<b>5 ESGのさらなる推進</b>	<b>5</b> グローバル本社経営体制強化のため、CxO制を導入し経営陣のアカウンタビリティを明確化 ESG高度化の母体となる「ESG行動計画」を策定・推進。事業を通じた社会貢献の拡大と、FY22におけるESG外部評価改善に寄与

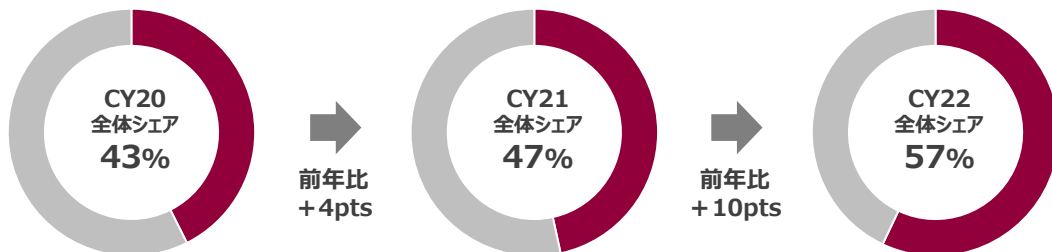
## ○ MTP2のこれまでの主な進捗

- 当社は、今後10年、どうありたいか、何をなすべきかを定めた、10年計画であるグランドデザインを2018年に定め、その実現に取り組んでいます。
- その中で、2期目の中期経営計画（MTP2）は、今後ますます発展が見込まれる半導体市場の中で、当社がより大きく発展するための基盤固めを進める3年間として活動しています。
- このスライドでは、MTP2における2年間の当社の主な進捗を整理しています。
- 半導体の複雑化が進む中で、技術トレンドを見据えた、R&Dの推進や今後の成長領域に対するM&Aを実施しました。2022年度においては、メモリ・テスト・セルの新機軸として「inteXcell」の投入や、パワー半導体用試験装置専門のイタリア・CREA社買収を実施しています。
- また、顧客ニーズへのきめ細やかな対応力強化のため、セールス・サポート人材の増強や、今後の業容拡大を見据えた人材の確保なども進展しました。
- オペレーショナル・エクセレンスの追求においては、グローバル・ビジネス・オペレーション・イニシアティブを発足し、業務プロセスの改革を目指した活動を始めました。
- ガバナンス面では、グローバル本社経営体制強化のため、CxO制を導入し経営陣のアカウンタビリティの明確化を図りました。また今年1月にはGroup CEO、Group COO、Group Co-COOを指名し、代表取締役を3名としました。
- 顧客満足度を持続的に高いレベルで充足しつつ、当社の成長基盤はより広く、より堅くなっていると感じています。

## 半導体テスト市場およびシェアの状況

市場規模 約\$4.2B → 前年比+32% → 約\$5.6B → 前年比-6% → 約\$5.2B

■ 当社  
■ 他社



	市場規模	当社シェア
SoCテスト	約\$3.0B	38%
メモリ・テスト	約\$1.2B	56%

	市場規模	当社シェア
SoCテスト	約\$4.3B	45%
メモリ・テスト	約\$1.3B	51%

	市場規模	当社シェア
SoCテスト	約\$4.0B	58%
メモリ・テスト	約\$1.2B	53%

Source: Advantest

### ○ 半導体テスト市場およびシェアの状況

- 暦年ベースの2022年の半導体テスト市場は、SoCテストは約40億米ドル、メモリ・テストは約12億米ドル、合計約52億米ドルと、対前年成長率はマイナス6%程度の規模であったと推定しています。主要民生機器向けの半導体需要の落ち込みによる影響を受けた一方、高性能半導体向けの技術進化がテスト需要をけん引することで、市場規模の落ち込みを一定程度補ったとみています。
- マーケットシェアは、57%程度と、前年から10ポイントほど伸ばすことができたのではないかと試算しています。SoCテストではおよそ58%、メモリ・テストではおよそ53%とそれぞれ2年連続で首位を獲得したものとみています。
- 2022年は市場規模が縮小する中で、HPCやAI関連といった高性能半導体向けテスト市場において当社はマーケットシェアを拡大し、売上を伸ばすことができました。



## 事業環境と半導体テスト市場の動向 <23年4月時点の見方>

### <事業環境：景気後退リスクが一層深まる>

- インフレ進行や金利上昇などによる世界経済の景気後退リスクの増大に加え、地政学的リスクの拡大や急速な為替変動リスクも懸念

### <半導体市場：前年比減少を見込む>

- 主要民生機器向けの半導体需要の減速から、関連する半導体メーカーでの在庫調整や生産調整は当面継続するものと予想

### <半導体テスト市場：2年連続で規模縮小を見込む>

- 高性能半導体向けのテスト量の増加がテスト需要を一定量サポートするも、半導体需要低迷の継続により前年比規模縮小を見込む

	CY21実績	CY22実績	CY23推定
SoCテスト市場	約\$4.3B	約\$4.0B (1月時点推定: 約\$3.9B - 4.1B)	約\$3.4B - 3.8B (1月時点推定: 約\$3.5B - 4.2B)
メモリ・テスト市場	約\$1.3B	約\$1.2B (1月時点推定: 約\$1.2B - 1.3B)	約\$0.9B - 1.1B (1月時点推定: 約\$0.9B - 1.2B)

Source: Advantest

### ○ 事業環境と半導体テスト市場の見方

- ・ インフレの進行や金利上昇などによる、世界経済の景気後退リスクの増大に加え、地政学的リスクの拡大や急激な為替変動リスクなど、事業環境の先行き不透明感がさらに高まっています。
- ・ 世界経済の低迷により、半導体市場では最終需要が減少していることで、余剰在庫や生産調整が発生している状況です。スマートフォンなど、主要民生機器向けの半導体需要が増加に転じるには、今後6～9ヶ月を要すると見込んでいます。
- ・ このような環境のもと、半導体テスト市場は2年連続で規模が縮小するものと見込んでいます。
- ・ 2023年のSoCテスト市場は、前年比減少の、米ドルで34億ドルから38億ドルの間と予想しています。車載・産機向けのテスト需要は底堅さを見込む一方、民生機器向けのテスト需要の落ち込みが年前半は継続するとみています。
- ・ 2023年のメモリ・テスト市場は、ハイエンドメモリ向けの戦略的な投資は持続すると見込むものの、メモリ半導体市況の悪化の影響を受け、前年比減少の米ドルで9億ドルから11億ドルと予想しています。
- ・ しかしながら、長期的には、電気自動車やChatGPTなど新たなアプリケーションによる半導体の需要増加が半導体テスト市場規模拡大に貢献すると見込んでいます。

## FY23業績予想

(億円)

	FY22 実績	FY23 予想	前年度比	
			増減額	増減率
			売上高*1	5,602
営業利益	1,677	1,050	-627	-37.4%
営業利益率	29.9%	21.9%	-8.0pts	
税引前利益	1,713	1,035	-678	-39.6%
当期利益	1,304	780	-524	-40.2%
当期利益率	23.3%	16.3%	-7.0pts	
研究開発費	601	630	+29	+4.8%
設備投資	250	210	-40	-16.0%
減価償却費	214	230	+16	+7.5%
為替レート*2	1米ドル	134円	130円	4円 円高
	1ユーロ	140円	140円	-

\*1:合計にはセグメント間の内部取引の消去分が含まれます

\*2:為替レート変動がFY23の営業利益に与える影響の最新見通しは、対米ドルが1円安時+11億円です。対ユーロは-3億円です

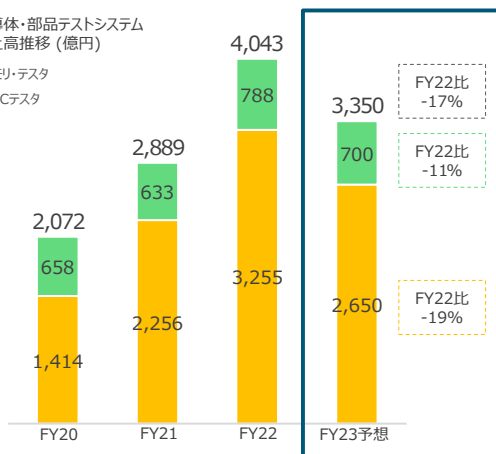
### ○ 2023年度の業績予想

- テスタ市場の減速を受けて、2023年度は売上高4,800億円、営業利益1,050億円、税引前利益1,035億円、当期利益780億円と減収減益を予想しています。
- 顧客の在庫調整や生産調整は当面継続する見込みであり、上期は売上が落ち込むとみていますが、下期から徐々に増加傾向に転ずると想定しています。
- 通期の売上総利益率は、55%程度を想定しています。主に製品ミックスの変動で前年度から悪化を見込みます。
- 2024年以降に立ち上がる新規のプロジェクトやアプリケーションへの対応に向けて、研究開発や設備投資は継続することから、営業利益率は21.9%と低下する見込みです。
- 予想の前提とした為替レートは、米ドルが130円、ユーロが140円です。
- 為替レート変動が2023年度の営業利益に与える影響の最新見通しは、通期で対米ドルでは1円安時+11億円、対ユーロでは-3億円です。
- なお米国および同盟国による半導体製造装置の対中輸出規制強化に関して、現時点では、当社の2023年度の業績に対する直接的な影響は限定的と考えておりますが、状況を注視してまいります。

## FY23見通し（事業別）

半導体・部品テストシステム  
売上高推移（億円）

■ メモリ・テスト  
■ SoCテスト



### 半導体・部品テストシステム事業

#### <SoCテスト>

– 広範囲な領域でテスト投資の抑制が実施される見込み。先端プロセス品向け、成熟プロセス品向けともに需要の落ち込みを想定

アプリケーション別内訳	FY20	FY21	FY22	FY23(予)
コンピューティング・通信	55%	60%	65%	60%
車載・産業機器・民生・DDIC*	45%	40%	35%	40%

内訳比率は実数ではなく、5%近似値で丸めて表示しています

#### <メモリ・テスト>

– ハイエンド・メモリ向けを中心に技術投資が一定量続くものの、メモリ半導体での市況悪化の影響を受け減収を見込む

アプリケーション別内訳	FY20	FY21	FY22	FY23(予)
DRAM	60%	60%	60%	70%
不揮発性メモリ	40%	40%	40%	30%

内訳比率は実数ではなく、5%近似値で丸めて表示しています

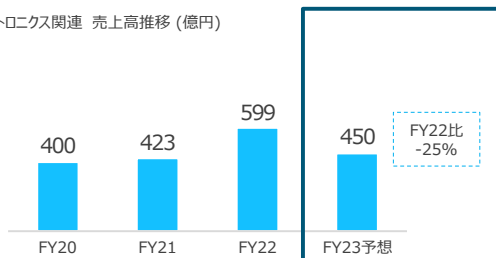
\* DDIC: ディスプレイ・ドライバーIC

### ○ 半導体・部品テストシステム事業の今期見通し

- SoCテストの2023年度通期売上予想を2,650億円とします
- 広範囲な領域でテスト投資の抑制が実施される見込みです。世界経済の落ち込みを受け、スマートフォンやデータセンター用途など先端プロセス品向け、車載・産業機器関連の成熟プロセス品向けともに需要の低下を想定しています。
- メモリ・テストの2023年度通期売上予想は700億円とします。
- ハイエンド・メモリの長期的な需要拡大に向けて、顧客の投資は一定量継続するものの、メモリ半導体の市況悪化を受けて、当社のメモリ・テスト売上も低下する見込みです。

## FY23見通し（事業別）

メカトロニクス関連 売上高推移（億円）

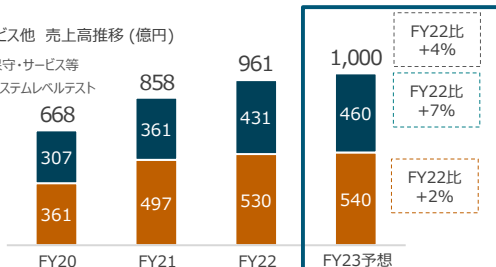


### メカトロニクス関連事業

- テスタ投資減速に伴い、デバイス・インタフェース製品やテスト・ハンドラは減収を予想
- ナノテクノロジー製品は、顧客におけるEUV露光の普及に加え、成熟プロセス向けフォトマスク需要増を背景に前年度並みの売上を予想

サービス他 売上高推移（億円）

■ 保守・サービス等  
■ システムレベルテスト



### サービス他事業

- 当社製品の設置台数の着実な伸びにより、保守サービスの需要は堅調
- システムレベルテスト事業は民生機器関連での市況低迷の影響を受けやすく、前年度並みの売上を見込む

## ○ メカトロニクス関連、サービス他事業の今期見通し

- ・ メカトロニクス関連事業の、2023年度通期売上予想は450億円とします。
- ・ テスタ投資減速に伴い、関連するデバイス・インタフェース製品やテスト・ハンドラの売上が減少する見込みです。ただしナノテクノロジー製品はEUV露光の普及に加え、成熟プロセス向けフォトマスク需要増を背景に、前年度並みの売上を予想しています。
- ・ サービス他事業については、2023年度通期売上予想を前年度比増収の1,000億円とします。
- ・ 当社製品の設置台数の着実な伸びを受けて、サービス保守事業の底堅い需要増を見込んでいます。
- ・ システムレベルテスト事業においては、前年度に民生機器関連での市況低迷の影響により、今年度に売上延伸されたものを含め、前年度並みの売上を見込んでおります。

## FY23の主要施策

### MTP2目標の達成に向けて邁進するとともに、より強固で強靱な経営基盤づくりを目指す

#### ・最先端の試験技術の開発を通じた、さらなる顧客価値の創造

- AI関連やパワー半導体など、高成長領域のリーダー顧客に訴求するテスト・ソリューションの拡充
- 将来の事業拡大に向けた成長投資の継続
- 協業先との緊密な連携の元、データ・アナリティクス分野の事業基盤をさらに強化

#### ・オペレーショナル・エクセレンスの追求

- 需要変動への追従力を高めるべく、サプライチェーン管理を高度化
- 全社オペレーションの効率向上のため、DXを積極的に活用  
(グローバル・ビジネス・オペレーション・イニシアティブの活動強化)

#### ・中長期的な視座のもと、人的資本の高度化も含めESGのさらなる推進に尽力

### ○ 2023年度の主要施策

- ・ 現状は、2022年後半から始まった半導体市場の調整の最中にあり、調整のボトムアウトまでは、もう少し時間を要すると見込むものの、2024年にかけて再び向上くものと想定しています。
- ・ MTP2の最終年度である2023年度は、MTP2目標の達成に向けて邁進するとともに、次の需要の波に備え、より強固で強靱な経営基盤づくりを推進する1年と位置づけ、主要施策を掲げています。
- ・ AI関連やパワー半導体向けなど、今後の成長市場におけるテスト・ソリューションのさらなる拡充や、データ・アナリティクス分野の事業基盤強化など、最先端の試験技術の開発を通じて、さらなる顧客価値の創造に努めていきます。
- ・ 将来の事業拡大のための新たなプロジェクト向けなどへの、必要な成長投資は継続していきます。
- ・ また、需要変動への耐性を高めるサプライチェーン管理の高度化や、全社レベルでの生産性向上のためDXを積極的に活用するなど、オペレーショナル・エクセレンスの追求に取り組みます。
- ・ 最後に、当社は先月末サステナビリティ説明会を初めて開催いたしました。そこで、当社の企業価値向上にかかわるキー要素の一つとして、人的資本強化の取り組みを説明させていただいています。当社の持続的な成長を支えるための中長期的取り組みとなりますが、従業員個々人のスキル向上、グローバルでの人事制度の整備をはじめとした、人的資本の高度化も含めESGのさらなる推進に努めてまいります。

---

**ADVANTEST®**